

锦州神工半导体股份有限公司

关于 2023 年年度报告的补充及更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“2023 年年度报告”）。经事后审核及公司自查，发现年报部分内容需要补充及更正。本次更正不涉及对财务报表的调整，不会对公司 2023 年度财务状况及经营成果产生影响。

一、补充情况

（一）“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（四）经营风险”进行了补充披露，具体如下：

“5.市场开拓及竞争风险

.....

为加快 8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目实现效益，公司已采取及拟采取的措施包括：

1) 调整募投项目建设节奏，稳步推进募集资金投入

公司于 2021 年 12 月 27 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2023 年 2 月。公司于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目“8

英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”的预定可使用状态日期调整至 2024 年 2 月。

前述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，已经过公司审慎研究论证并由董事会审议通过，项目进度变化是为了更好地实施募投项目，不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

公司结合实际经营发展需求进行调整，稳步推进募集资金投入，以最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。

2) 持续优化募投项目管理，确保募投项目实施进度

为保证募投项目本次延期后能够顺利完成，公司采取了如下措施：（1）由专人负责该募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；（2）指定募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方进行沟通与协调，配合做好各项工作，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目按计划推进；（3）对设备安装及调试情况持续保持关注，对于可能拖延项目实施进度的情况及时向公司负责人汇报。

3) 发挥技术及人才优势，加强募投项目人员支持

公司专注于生产技术门槛更高、市场容量更大的轻掺低缺陷抛光硅片，依靠在日本拥有 20-30 年轻掺低缺陷硅片生产经验的核心技术团队，持续深入 8 英寸无缺陷晶体的工艺开发，全面掌握了晶体内部缺陷的控制方法。同时，公司始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才，人才储备丰富。

为了保障研发项目工作的顺利开展，公司成立了专门的项目开发小组，保障在研项目的人员配置。项目开发小组的主要成员均具有多年的半导体行业技术开发、工艺研究和生产组织管理方面的经验，能够确保在研项目按计划实施。公司将持续通过内部培养和外部引进的方式完善技术团队、提高技术实力，为项目配备经验丰富的人员，利用技术及人才优势加强对项目的技术支持，从而加快项目的效益实现进程。

4) 与供应商加强沟通合作，提高产品研发测试效率

对于募投项目的实施过程所需的设备、原材料及相关服务等，公司实施严格的供应商准入制度，设有合格供应商名单，并对该名单中的合格供应商服务进行定期考核和评定。在具体项目执行时，通常会综合考虑供应商产品或服务的稳定性、成本结构以及时间周期等因素，持续与供应商保持沟通，以确保相关研发测试工作的顺利开展，提高产品研发过程中的测试效率。

5) 提前与关键客户沟通对接，加快产品验证过程

公司 8 英寸硅片产品的正片认证周期较长，预计需要 9-18 个月，但一旦相关认证工作完成，芯片制造厂商通常不会轻易更换供应商。公司在研发过程中即提前与客户进行沟通对接，工艺实验围绕重点客户的特殊硅片工艺要求推进，并充分借鉴现有产品研发和测试分析经验以缩短产品的认证周期。公司某款硅片已定期出货给某家日本客户，其各项指标已经满足了正片标准，另外公司 8 英寸测试片已经是国内数家集成电路制造厂商该材料的合格供应商。后续公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作，并积极开拓中国本土大尺寸硅片市场需求，力争通过主流集成电路制造厂商的正片评估并取得相应订单。

6. 毛利率下滑的风险

近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，未来随着公司刻蚀用多晶硅材料销售规模的扩大以及募投项目建成后新增设备折旧的计提，若公司不能持续推出具有市场竞争力的优质产品，并通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本，则可能面临大直径硅材料业务毛利率进一步下滑的风险。

公司已采取或拟采取的应对措施包括：

1) 积极开拓市场，加强客户开发与维护，持续拓展国内外营销网络

公司持续挖掘市场深度，维护巩固现有客户的合作关系，公司产品主要销往日本、韩国等国家和地区。凭借先进的生产制造技术、高效的产品供应体系以及良好的综合管理能力，公司与客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司已成功进入国际先进半导体材料产业链体系，在行业内拥有了一定的知名度。未来，公司将利用先发优势，凭借过往合作的良好关系和公司产品质量口碑，通过完善客户管理、提升客户服务水平等方式增强客户粘性，持续提高和现有客户的合作紧密程度，争取现有客户的持续性业务机会，并努力扩大业务合作规模。

公司拓宽市场广度，积极开拓新客户。在巩固与重点客户长期稳定的良好合

作关系同时，公司尤其注重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触。未来，公司将继续以客户为中心，在原有营销体系的基础上，通过扩大和完善国内销售及售后服务网络建设，加强国内市场盲区覆盖，抓住国内半导体行业发展的机遇，凭借优质的产品性能和服务能力，积极拓展和培育符合公司整体战略方向的具有市场影响力的国内客户，扩大国内市场销售的份额。

2) 加大技术研发投入，优化产品结构，保持产品竞争力

公司以行业技术发展趋势及客户核心需求为导向，持续培养和引进高素质研发技术人才，加大研发投入，储备新技术、新工艺，加强研发体系和能力建设，使公司保持高效的持续创新能力。一方面，公司将持续强化现有核心产品的技术优势，保持现有产品的核心竞争力，并重点加强为客户提供定制化产品与解决方案的能力；另一方面，公司将加大对现有产品横向及纵向产品线的研发投入，致力于实现在半导体级单晶硅材料领域核心技术的突破，持续增强公司的行业竞争力和市场地位。

3) 加强供应链管理，降低采购成本

公司持续提升对原材料市场进行研究和分析能力，密切关注原材料行情信息，根据市场价格波动情况及预期未来走势，结合公司安全库存、未来订单和排产计划，合理调整主要原材料备货量，尽可能降低原材料的采购成本。同时，公司将不断加强供应商管理，在与供应商保持长期稳定的合作关系的同时，积极开拓新的优质供应商，提高公司采购议价能力，在保证原材料品质的前提下，通过供应商询价与比价方式选择最有利的采购价格，不断降低采购成本。

4) 强化生产管理水平，提高生产效率

在材料成本方面，公司将继续优化生产工艺流程或提升生产线自动化水平等方式，以进一步降低生产过程的材料损耗、提升产品良率和产品一致性；在人工成本方面，公司将通过优化生产安排、提升生产自动化水平等方式，强化公司生产现场管理水平，进一步提高一线生产效率，降低生产成本。”

(二) “第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“(五) 财务风险”进行了补充披露，具体如下：

“报告期末，公司应收账款余额为 6,032.49 万元，坏账准备余额为 813.52 万元。公司应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关，受半

导体行业下行周期影响，公司下游客户销量减少，回款压力增加，出现阶段性短期逾期的情况。若未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，将对公司财务状况产生不利影响。

针对应收账款的逾期风险，公司采取多项措施加大逾期款项的清理力度，同时逐步完善应收账款的内部控制和规范回款、催款的管理。公司采取的主要措施包括：

（1）从公司层面加强对应收账款管理工作的重视，将应收账款管理作为公司级的重点工作事项，加强对回款工作的考核，将回款作为销售部门及员工的重点工作目标和指标；

（2）提高对逾期应收账款跟踪的频率，公司财务和销售等相关部门每周召开应收账款回款例会，分析客户回款情况和存在的风险，对重点客户和逾期项目重点监测和跟踪；

（3）形成从发生、分析、例会跟踪到监督、考核的完整闭环应收账款管理机制。

未来公司将进一步完善应收账款内部控制管理，从信用政策、回款跟踪分析、回款催收、考核和激励等全过程提升应收账款管理工作的质量，完善应收账款内部控制活动的设计、加强控制活动的执行等方面降低应收账款逾期的风险。”

二、更正情况

（一）“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（五）投资状况分析”之“3. 以公允价值计量的金融资产”进行更正：

更正前:

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
金融衍生工具	55,016,667.22	121,681.44			136,817,225.00	150,820,214.00	-498,368.53	40,636,991.13
其他	5,625,319.86		25,409.80				-415,189.04	5,235,540.62
合计	60,641,987.08	121,681.44	25,409.80		136,817,225.00	150,820,214.00	-913,557.57	45,872,531.75

更正后:

单位:元 币种:人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
理财产品	55,016,667.22	121,681.44			136,817,225.00	150,820,214.00	-498,368.53	40,636,991.13
其他	5,625,319.86		25,409.80				-415,189.04	5,235,540.62
合计	60,641,987.08	121,681.44	25,409.80		136,817,225.00	150,820,214.00	-913,557.57	45,872,531.75

(二) “第十节 财务报告”之“十三、公允价值的披露”之“1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值”进行更正:

更正前:

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(一)交易性金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 应收款项融资		120,822.26		120,822.26
(三) 其他债权投资				
(四)其他权益工具投资			5,114,718.36	5,114,718.36
(五) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中:发行的交易性债				

券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(一)交易性金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			40,636,991.13	40,636,991.13
(1)债务工具投资			40,636,991.13	40,636,991.13
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(二)应收款项融资		120,822.26		120,822.26
(三)其他债权投资				
(四)其他权益工具投资			5,114,718.36	5,114,718.36
(五)投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				

3.持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五)生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的 资产总额		120,822.26	45,751,709.49	45,872,531.75
(六)交易性金融负债				
1.以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债				
其中：发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

二、其他说明

除上述更正内容外,《2023年年度报告》其他内容保持不变,更正后的《2023年年度报告》将与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,提高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年5月11日